



31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition in Rzeszów-Krasiczyn

Vom 23. bis zum 26. September fand in Rzeszów-Krasiczyn die 31. Polnische IMAPS-Konferenz statt. In diesem Jahr wurde damit gleichzeitig das 25jährige Bestehen von *IMAPS Poland* (vormals *ISHM Poland*) begangen. Polen war seinerzeit das einzige „Ostblock“-Land mit einem eigenen *ISHM*-Chapter und der besondere Charakter dieser Veranstaltung resultiert immer noch ein wenig aus dieser Pionierrolle. Einige der 12 Gründungsmitglieder konnten auf der Tagung begrüßt werden. Die *IMAPS Poland*-Konferenz ist traditionell eine internationale Veranstaltung. In diesem Jahr waren 130 Teilnehmer angereist, von denen 40 aus 17 verschiedenen Ländern kamen. Auch die deutsche „Abordnung“ konnte sich wieder sehen lassen.

Der Tagungsort war in diesem Jahr das Schloss in Rzeszów-Krasiczyn, welches im äußersten Südosten Polens nahe der ukrainischen Grenze gelegen ist. Dieses Schloss liegt inmitten einer sehr schönen Parkanlage und bot eine gute Kulisse für die Tagung und die Abendveranstaltungen. Die Organisation wurde in diesem Jahr von der *Technischen Universität Rzeszów* übernommen. Das wissenschaftliche Programm bestand aus mehreren Plenarveranstaltungen mit eingeladenen Vorträgen sowie einer Anzahl von Postersessions, bei denen die Autoren vor ihren Postern mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch kamen. Das Themenspektrum reichte dabei von Materialfragen über die klassische Hybrid- und die LTCC-Technologie bis zu Sensoren, Applikationen von Nanostrukturen und neuen Lösungen für die alternative Energieversorgung. Insgesamt wurden 170 Beiträge vorgestellt. Das vollständige Konferenzprogramm kann unter <http://imaps.prz.edu.pl> eingesehen werden.

Zu den Traditionen der polnischen *IMAPS*-Veranstaltungen gehört auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. In diesem Jahr waren dies Exkursionen nach Lwow und Przemysl und die Abendveranstaltungen, für die sogar das Schlossgespenst reaktiviert wurde.

Zum Abschluss einer sehr gut organisierten und fachlich interessanten Tagung wurde der Blick auf die internationalen *IMAPS*-Veranstaltungen des kommenden Jahres

gelenkt. *Jens Müller, IMAPS Deutschland*, lud zur *CICMT 2008* ein, die als gemeinsame Veranstaltung von *IMAPS N.A.*, *IMAPS Deutschland*, *AcerS* und der *DKG* vom 21. bis zum 24. April 2008 in München stattfinden wird (www.imaps.org/callfor/CICMT2008.pdf). Das nächste größere Ereignis ist dann die *ESTC 2008* in Greenwich, U.K., eine gemeinsame Veranstaltung von *IMAPS* und *IEEE*, über die *Chris Bailey* anschließend informierte (<http://141.30.122.65/ESTC2008.html>).

Vorstellung von Firmenmitgliedern

Anfang September hat der Vorstand per Brief die *IMAPS*-Mitglieder u.a. über neue Leistungen für Firmenmitglieder informiert. Dazu gehört, dass die Mitgliedsfirmen die

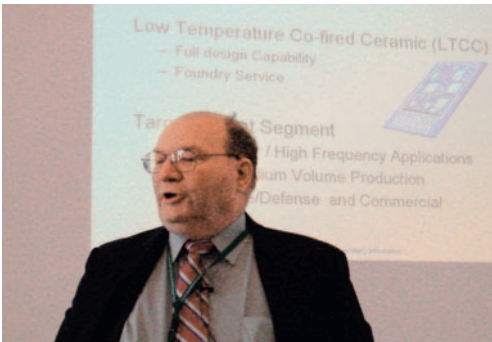


Das Schloss in Krasiczyn – ein eindrucksvoller Tagungsort

Möglichkeit erhalten, auf der *IMAPS*-Webseite ein Kurzprofil sowie einen Link zum eigenen Internetauftritt zu platzieren. Die Kurzprofile sollen in loser Folge auch hier veröffentlicht werden und wir wollen in dieser Ausgabe damit beginnen.



Die Postersessions boten Gelegenheit für einen ausführlichen Informationsaustausch



Mike Ehlert, IMAPS N.A., bei seinem Beitrag zu aktuellen Entwicklungen der LTCC-Technologie



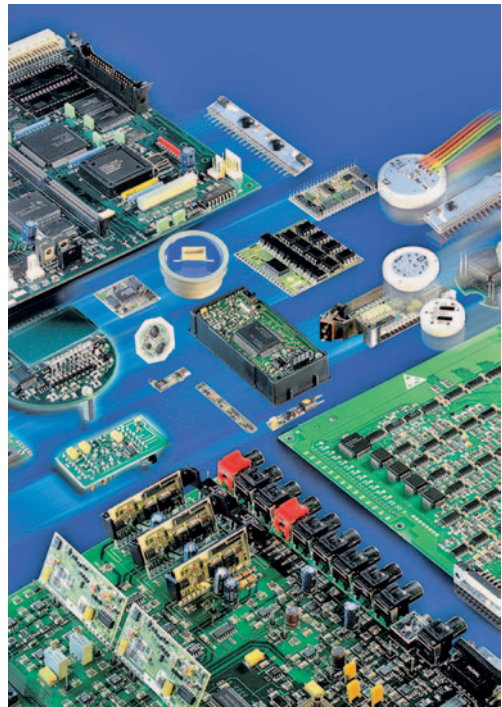
Chris Bailey lud zur ESTC 2008 in Greenwich ein

SIEGERT electronic GmbH

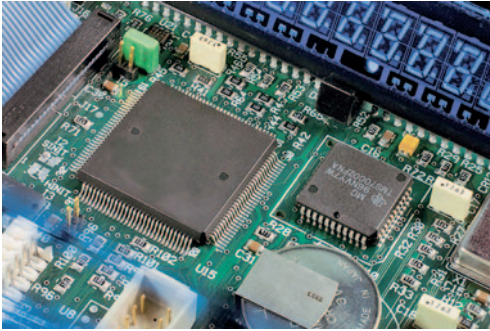
Die Firma *SIEGERT* wurde 1945 gegründet. In den 50er Jahren konzentrierte sich das Unternehmen auf die Herstellung von Schichtwiderständen. 1965 begann man mit der Produktion von Miniaturwiderständen für die Medizintechnik. Anfang der 70er Jahre wurde die Dickschichttechnik eingeführt. Daraus entwickelte sich ein eigener Geschäftsbereich, die *SIEGERT-Hybridtechnik*. Für diesen stark expandierenden Bereich wurde 1975 eigens ein Werk in Cadolzburg-Egersdorf errichtet, das 1980, 1985 und 2006 erweitert wurde.

Die 90er Jahre führten zu einer strategischen Neupositionierung der *SIEGERT*-Gruppe. Der Produktbereich *Widerstände* wurde ausgegliedert. Durch Beteiligungen entstanden neue Gesellschaften und ein Verbund mittelständischer Elektronikunternehmen mit dem Namen *MICROTELGROUP*. Alle Unternehmen dieses Firmenverbundes entwickeln und produzieren Bauelemente, Baugruppen, Sensoren und Komplettsysteme für die verschiedensten Anwendungsbereiche der Elektronik.

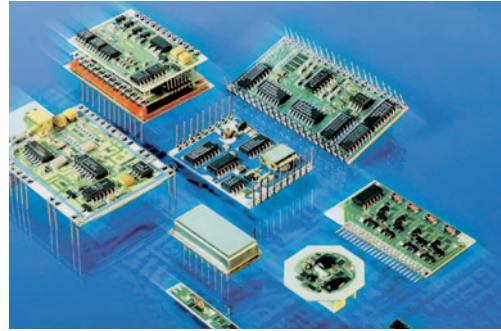
Siebert electronic versteht sich als Full-Service-Dienstleister – kundenorientiert, innovativ und offen. Das Angebot reicht von der Entwicklung über Fertigung bis zum After Sales-Service. Das Technologie-Angebot umfasst Dickschicht-Hybride und Netzwerke, bestückte



Produktspektrum der SIEGERT electronic GmbH



Blick auf eine bestückte SMD-Platine



Hybridbaugruppen gehören ebenfalls zum Technologie-Angebot

Leiterplattenbaugruppen, kompletten Subsystemen und kundenspezifische Lösungen. Design for Cost, Manufacturing und Test sind während der Layouterstellung maßgebliche Aufgabenstellungen. *Siegert electronic* definiert die Aufbau- und Verbindungstechnologie, fertigt Prototypen und führt im Anschluss Produktreviews u.a. mit Zuverlässigkeitstests durch. Ein internationales Beschaffungsmarketing sichert die markt- und umweltgerechte Versorgung der Produktion mit Bauelementen, Hilfs- und Betriebsstoffen und anderen Zulieferteilen, auch in Allocation-Situationen. Dabei wird sehr großen Wert auf Supply Chain-Management, Lieferantenentwicklung und Materiallogistik gelegt. Eine flexible und reproduzierbare Fertigung – vollautomatisiert für große Stückzahlen, teilautomatisiert für mittlere Mengen, manuelle

Arbeitsplätze für kleine Volumina – ist die Basis für die rationelle Herstellung der Produkte, mittels modernstem Fertigungsequipment und State-of-the-art-Technologien. Im After-Sales-Service sind Reklamationsmanagement, Ersatzteilversorgung und End-of-Life-Service wichtige Bestandteile. Im Falle des Falles verpflichtet sich *Siegert electronic* zur Fehleranalyse, Identifikation und Beseitigung unter Anwendung von dokumentierten Qualitätsprozessen und zur Verbesserung ihrer Dienstleistung mit Hilfe der gewonnen Erkenntnisse.

Zentraler Bestandteil von *Siegert electronic* ist ein nach ISO TS16949:2002 zertifiziertes und praktiziertes QM-System.

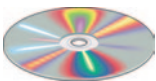
Siegert electronic GmbH, Pfannenstielstrasse 10, 90556 Cadolzburg, Tel. 09103/5070, Fax 09103/1789, zentrale@siegert.de, www.siegert.de

Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
San Jose	10./15.11.2007	IMAPS 2007 – 40 th International Symposium on Microelectronics	IMAPS NA
München	21./24.4.2008	CICMT 2008	IMAPS NA, AcerS, DKG, IMAPS D
London, Old Windsor	11./12.6.2008	Micro Tech 2008	IMAPS UK
Greenwich	1./4.9.2008	ESTC 2008	IEEE/CPMT

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der *IMAPS-Herbsttagung 2007*, die am 8./9. Oktober 2007 in München stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papierausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller
1. Vorsitzender
c/o ZiK MacroNano
Applikationszentrum Ilmenau
Gustav-Kirchhoff-Str. 5
98693 Ilmenau
Fon: 03677/69-3381
Fax: 03677/69-3379
e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar
2. Vorsitzende
c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie
Albrecht-Erhard-Str. 17
D-73433 Aalen
Fon: 07361/931129
Fax: 07361/943004
e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps
Schatzmeister
c/o Hesse & Knipps GmbH
Vattmannstraße 6
D-33100 Paderborn
Fon: 05251/1560-14
Fax: 05251/1560-97
e-mail: hans-ulrich.knipps@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer
Schriftführer
c/o FH Schmalkalden
FB Elektrotechnik
D-98574 Schmalkalden
Fon: 03683/688-5116
Fax: 03683/688-5499
e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit
und Mikrointegration
Chip Interconnection Technologies
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
Fon: 030/46403-164
Fax: 030/46403-161
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VIA electronic GmbH
Robert-Friese Straße 3
D-07629 Hermsdorf
Fon: 036601/81-529

Fax: 036601/81-530
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
D-10623 Berlin
Fon: 030/310078-242
Fax: 030/310078-256
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI
FG Mikroperipherik
Pf 100565
D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing
D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de

[Potentielle Buch-Autoren]

für die Bereiche Leiterplattentechnik · Baugruppenteknik Mikrosystemtechnik · Nanotechnologie

Wenn Sie gerade dabei sind, ein Manuskript zu schreiben oder sich mit dem Gedanken tragen, ein solches in der Zukunft zu erstellen, entweder als alleiniger Autor oder als Co-Autor; wenn Sie alternativ daran interessiert sind, ein Buch herauszubringen oder sich an einem Buch als Autor beteiligen möchten, so würde der Leuze Verlag gerne darüber mit Ihnen sprechen.

Wenden
Sie sich bitte an
Herrn K. Reichert
kurt.reichert@leuze-verlag.de

EUGEN G.
LEUZE
VERLAG

Karlstraße 4
D-88348 Bad Saulgau
Tel. 07581/4801-0
Fax 07581/4801-10

105 JAHRE 1902 – 2007